

# 公司概況資料表

以下資料由宏碩系統股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

## 認購相關資訊

### 公司簡介

### 風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

### 主要業務項目

### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

### 最近五年度簡明資產負債表

### 最近三年度財務比率

公司名稱：宏碩系統股份有限公司 (股票代號：6895)

申請登錄：■一般板 □戰略新三板

董事長	趙勤孝
總經理	陳漢穎
資本額	310,000,000元
輔導推薦證券商	兆豐證券股份有限公司 中國信託綜合證券股份有限公司 元大證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	兆豐證券股份有限公司 賴小姐(06)223-0398 #216
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購宏碩系統股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦	協辦
	兆豐證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
認購日期	111年08月30日	111年09月06日	111年08月30日
認購股數(股)	730,000	100,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.36%	0.32%	0.32%

認購價格	每股新臺幣58元																																	
認購價格之訂定 依據及方式	<p>一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式 本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為宏碩系統股份有限公司(以下簡稱宏碩或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>二、承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較，目前股票價值評估方法眾多，各方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：</p> <p>(1)市價法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio, P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。</p> <p>(2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。</p> <p>(3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值評定之基礎。</p> <p>以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。</p> <p>三、發行人與已上市櫃同業之本益比之比較情形</p>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>公司別</th> <th>主要營收項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全訊(5222)</td> <td>主要從事發展高頻通訊、高輸出功率、高可靠性的微波功率放大器等元件為主</td> </tr> <tr> <td>瑞耘(6532)</td> <td>主要從事半導體設備、系統設備零組件之製造</td> </tr> <tr> <td>意德士(7556)</td> <td>主要從事半導體生產製程中所使用之精密零組件、材料與製程次系統的製造、銷售、維修與技術服務</td> </tr> </tbody> </table>	公司別	主要營收項目	全訊(5222)	主要從事發展高頻通訊、高輸出功率、高可靠性的微波功率放大器等元件為主	瑞耘(6532)	主要從事半導體設備、系統設備零組件之製造	意德士(7556)	主要從事半導體生產製程中所使用之精密零組件、材料與製程次系統的製造、銷售、維修與技術服務																									
	公司別	主要營收項目																																
全訊(5222)	主要從事發展高頻通訊、高輸出功率、高可靠性的微波功率放大器等元件為主																																	
瑞耘(6532)	主要從事半導體設備、系統設備零組件之製造																																	
意德士(7556)	主要從事半導體生產製程中所使用之精密零組件、材料與製程次系統的製造、銷售、維修與技術服務																																	
<p>資料來源：各公司110年度年報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">採樣同業</th> <th colspan="4">本益比</th> </tr> <tr> <th>111/05</th> <th>111/06</th> <th>111/07</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全訊(5222)</td> <td>35.94</td> <td>39.62</td> <td>37.46</td> <td>37.67</td> </tr> <tr> <td>瑞耘(6532)</td> <td>15.07</td> <td>14.95</td> <td>13.90</td> <td>14.64</td> </tr> <tr> <td>意德士(7556)</td> <td>23.77</td> <td>24.47</td> <td>23.22</td> <td>23.82</td> </tr> <tr> <td>上櫃半導體類股</td> <td>18.24</td> <td>14.17</td> <td>14.05</td> <td>15.49</td> </tr> <tr> <td>上市半導體類股</td> <td>17.10</td> <td>14.12</td> <td>14.62</td> <td>15.28</td> </tr> </tbody> </table>	採樣同業	本益比				111/05	111/06	111/07	平均	全訊(5222)	35.94	39.62	37.46	37.67	瑞耘(6532)	15.07	14.95	13.90	14.64	意德士(7556)	23.77	24.47	23.22	23.82	上櫃半導體類股	18.24	14.17	14.05	15.49	上市半導體類股	17.10	14.12	14.62	15.28
採樣同業		本益比																																
	111/05	111/06	111/07	平均																														
全訊(5222)	35.94	39.62	37.46	37.67																														
瑞耘(6532)	15.07	14.95	13.90	14.64																														
意德士(7556)	23.77	24.47	23.22	23.82																														
上櫃半導體類股	18.24	14.17	14.05	15.49																														
上市半導體類股	17.10	14.12	14.62	15.28																														

資料來源：台灣證券交易所及財團法人中華民國櫃檯買賣中心

宏碩公司主要從事真空微波管及半導體設備零組件之研發、製造及銷售，為國內唯一真空微波管製造商，而半導體設備零組件則為透過異材質接合技術將陶瓷與金屬組成真空電引入元件(Feedthrough)及各種真空設備零件，經參採國內上市(櫃)公司中，並無經營業務完全相同的競爭同業，惟考量該公司業務型態、產品性質及營業項目，國內較為相近之上市櫃公司為全訊(5222)：其主要營業項目為生產及銷售固態微波功率放大器以及微波次系統；瑞耘(6532)：其主要營業項目為生產及銷售半導體設備及系統設備之零組件，如真空設備之相關零組件；意德士(7556)：其主要營業項目為生產及銷售半導體製程設備之精密零組件，如精密陶瓷零組件等，故選為採樣同業，若以110年稅後淨利90,380千元除以該公司預計興櫃掛牌時之股本310,000千元計算，每股盈餘為2.92元，依採樣公司及上市/櫃其他類股最近三個月平均本益比之簡單算術平均數14.64倍~37.67倍，並考量興櫃市場之流動性風險貼水而採八折計算，其每股合理價格區間為34.20元~88.00元，議定推薦證券商股票認購價格為58元，介於每股合理價格區間內，故議定之認購價格尚屬合理。

四、推薦證券商就其與發行人所共同議定承銷價格合理性之評估意見。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定係參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並考量該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格，尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司介紹

宏碩系統股份有限公司設立於民國91年12月31日，截至111年8月底止，實收資本額為新台幣310,000千元。主要從事真空微波管及半導體設備零組件之研發、製造及銷售，是以4H(High vacuum高真空、High voltage高電壓、High frequency高頻率、High power高功率)為核心技術。為國內唯一真空微波管製造商，且具有多項微波元件應用之專利，早期即為我國國防工業機構應用於尋標器上之微波管的主要供應商，在國防用途上，因所需頻率分布較寬、發射功率更高，加上需符合長時間置放的耐久性及安全性，故存在較高之技術門檻障礙，近年來則以符合國防產業標準之高門檻技術積極跨入商用領域，使其真空微波管產品除可應用於國防外，進而拓展至商用半導體領域。另運用異材質接合技術組成真空電引入元件(Feedthrough)及各種真空設備零件，主要應用於電子束(E Beam)檢測設備(E Scan)中，為該設備重要元件。市場應用跨足商用半導體及國防產業等領域。

### 二、歷史沿革

年 度	項 目
民國91年	1.成立宏碩系統有限公司，從事軍用真空微波管研發及生產，設立資本額為新臺幣1,000仟元。 2.設立地址於台北縣林口鄉自強二街1之2號。
民國94年	1.遷址至新竹市東區林森路147號11樓之1號。 2.遷址至新竹市東區林森路147號12樓之2號。 3.遷址至桃園縣龍潭鄉高原村渴望路185號3樓之2號。 4.現金增資9,000仟元，增資後實收資本額為新臺幣10,000仟元。
民國95年	1.現金增資11,828仟元，增資後實收資本額為新臺幣21,828仟元。 2.減資彌補虧損3,108仟元，減資後實收資本額為新臺幣18,720仟元。 3.取得 ISO9001 認證。
民國96年	現金增資9,100仟元，增資後實收資本額為新臺幣27,820仟元。
民國97年	現金增資2,480仟元，增資後實收資本額為新臺幣30,300仟元。
民國98年	1.現金增資15,000仟元，增資後實收資本額為新臺幣45,300仟元。 2.遷址至苗栗縣竹南鎮公義里友義路232號1樓。
民國99年	1.現金增資2,780仟元，增資後實收資本額為新臺幣48,080仟元。 2.投入半導體零組件維修市場，並開始進行相關半導體產品研發及生產。
民國100年	1.企業合併佳穎科技股份有限公司增資14,800仟元，增資後實收資本額為新臺幣62,880仟元。 2.現金增資5,075仟元、盈餘轉增資3,081仟元及資本公積轉增資1,446仟元，增資後實收資本額新臺幣72,482仟元。 3.取得真空顯示器的抽真空裝置之專利權。
民國101年	取得冷卻裝置及致冷裝置之專利權。
民國102年	1.盈餘轉增資3,624仟元，增資後實收資本額新臺幣76,106仟元。 2.取得適用穀物的微波除蟲卵裝置及微波加熱暨乾燥裝置之專利權。
民國103年	取得顯示器之抽真空裝置及抽真空方法之專利權。
民國104年	1.現金增資11,947仟元，增資後實收資本額為新臺幣88,053仟元。 2.取得美國 FIL for cooling storage container-patent 之專利權。
民國105年	現金增資11,947仟元，增資後實收資本額為新臺幣100,000仟元。
民國106年	1.遷址至苗栗縣頭份市中正路598巷31號。 2.盈餘轉增資30,000仟元，增資後實收資本額為新臺幣130,000仟元。
民國107年	盈餘轉增資20,000仟元，增資後實收資本額為新臺幣150,000仟元。
民國109年	1.辦理執行員工認股權發行新股22,500仟元，增資後實收資本額為新臺幣172,500仟元。 2.現金增資100,000仟元，增資後實收資本額為新臺幣272,500仟元。 3.現金增資37,500仟元，增資後實收資本額為新臺幣310,000仟元。 4.旭暉應用材料股份有限公司投資本公司並取得42.22%股權，本公司成為旭暉集團之合併個體。 5.取得膜狀物微波乾燥裝置之專利權。
民國110年	取得人造鑽石生產裝置及其微波發射模組之專利權。
民國111年	4月經證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。

### 三、經營理念

宏碩公司技術自主能力高，藉由偕同半導體製造業客戶及國防產業客戶進行技術研發，精進產品品質提高競爭力，全面落實「務實創新、精益求精、提供客戶最佳產品及服務」之經營理念，且基於半導體採購在地化及國防自主等地域優勢，參與客戶

之產業布局及資本支出計畫，成為客戶最值得信賴的夥伴。

#### 四、未來展望

##### 1.短期業務計畫

- (1)充分掌握市場訊息，以因應客戶多樣化、及時性的產品需求。並針對半導體廠商進行新客戶開發，持續擴大現有產品之市場占有率。
- (2)針對微波源設備之技術演進，開發適用性廣泛之微波加熱設備，積極擴展相關業務。
- (3)不斷精進產品規格及精度，拉高競爭者之進入門檻，並增進產品之競爭優勢。
- (4)配合市場需求，確實掌握交期，並提升及改善生產製造能力與品質目標，以提高生產力及降低生產成本。
- (5)加強員工教育訓練及積極培訓優秀人才，提升工作效率及營運管理能力；健全福利制度，凝聚員工向心力及提升經營績效。

##### 2.長期發展計畫

- (1)針對微波源設備之技術演進，開發鋰電池微波乾燥系統，並藉由製程設備之開發與改善，不斷提升產品良率。
- (2)適時提供技術諮詢，使能夠與下游客戶保持良好合作夥伴，隨時掌握市場脈動，配合客戶產品開發時程，以提升公司競爭力。

#### 風險事項說明(登錄戰略新版公司適用)

宏碩系統公司非申請登錄戰略新版公司，故不適用。

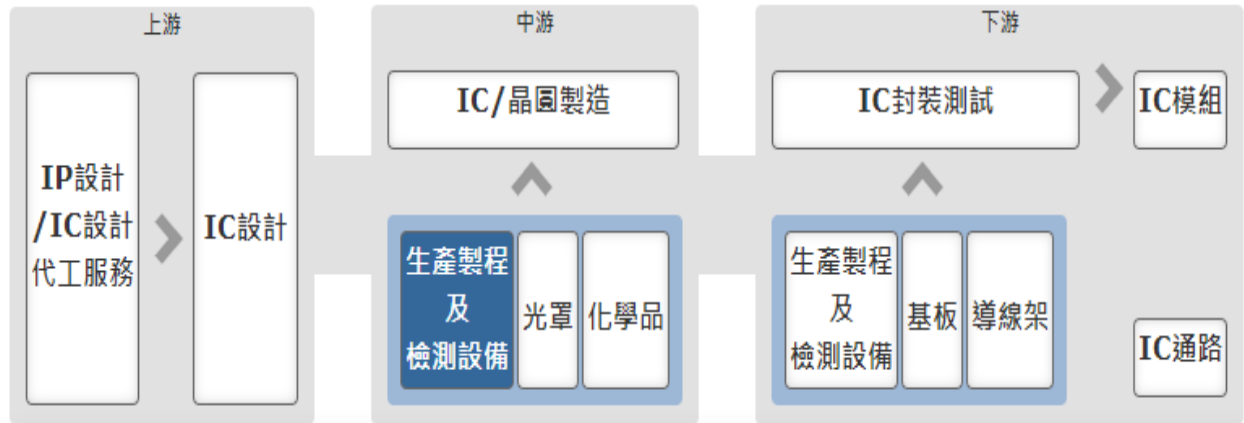
[TOP ^](#)


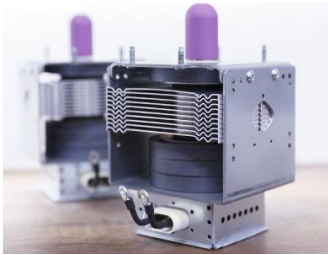
#### 主要業務項目：


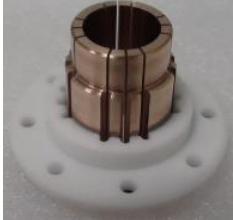
主要從事真空微波管及半導體設備零組件之研發、製造及銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

半導體產業鏈上游為IP設計及IC設計業，中游為IC製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等產業，下游為IC封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC模組、IC通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
真空微波管	<p>軍用微波管</p>  <p>商用微波管</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 應用於主動導引的軍用尋標或搜索設備上，如：飛彈尋標器、火箭信標、無人機信標。</li> <li>● 應用於半導體製程中，紫外線固化之設備裡的重要零組件，利用微波能量激發紫外線，凝固原本偏軟的半導體薄膜。</li> </ul>	222,146	61.33

半導體設備零組件	<p style="text-align: center;">真空電引入元件</p>  <p style="text-align: center;">真空設備零組件</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 應用異材質焊接技術製作的真空電引入元件(Feedthrough)及各種真空設備零件，係該公司專門為電子束(E Beam)檢測設備(E Scan)所開發之產品，真空電引入元件係將電流引入電子束檢測機內部的高真空環境中，而各種真空設備零件係作為真空環境封合或管線導入使用，均屬電子束檢測機中之關鍵元件之一。</li> </ul>	126,044	34.80
其他	—	—	14,001	3.87
合 計			362,191	100.00

TOP ^

**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**

單位：新臺幣千元

項目	年度	106年 (註1)	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年截 至7月份止 (自結數)(註2)
營業收入		209,032	193,082	145,204	280,382	362,191	221,539
營業毛利		95,009	54,270	38,684	132,544	187,787	108,089
毛利率(%)		45.45%	28.11%	26.64%	47.27%	51.85%	48.79%
營業外收入		460	1,109	529	354	639	1,634
營業外支出		8,887	2,730	2,692	925	70	479
稅前損益		55,854	27,878	11,669	79,993	112,357	64,922
稅後損益		46,325	22,299	8,481	63,548	90,380	51,584
每股盈餘(元)		3.56	1.49	0.57	2.94	2.92	1.66
股利 發放	現金股利(元)	1.67	1.34	0.50	1.80	2.50	—
	股票股利(資 本公積轉增 資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈 餘轉增資)(元)	1.54	—	—	—	—	—

註1：上列各年度財務資料經會計師查核簽證；106年度至108年度係依我國企業會計準則所編製之個體報表；109年1月1日起則依國際財務報導準則編製個別報表。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。



### 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	106年 (註)	107年 (註)	108年 (註)	109年 (註)	110年 (註)
流動資產		193,281	137,404	105,484	423,056	457,099
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		173,691	171,416	167,851	163,113	162,449
無形資產		—	—	—	10,611	11,541
其他資產		3,373	2,157	6,655	24,196	43,640
資產總額		370,345	310,977	280,833	627,583	675,763
流動 負債	分配前	72,002	35,939	26,840	66,603	80,456
	分配後	93,699	55,994	34,340	122,403	157,956
長期負債		—	—	—	—	—
其他負債		82,777	58,870	49,399	768	234
負債 總額	分配前	154,779	94,809	76,239	67,371	80,690
	分配後	176,476	114,864	83,739	123,171	158,190
股本		130,000	150,000	150,000	310,000	310,000
資本公積		28,937	28,937	28,937	168,507	168,788
保留 盈餘	分配前	56,630	37,231	25,657	81,705	116,285
	分配後	34,933	17,176	18,157	25,905	38,785
長期股權投資 未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
股東權益 總額	分配前	215,566	216,168	204,594	560,212	595,073
	分配後	193,869	196,113	197,094	504,412	517,573

註：上列各年度財務資料經會計師查核簽證；106年度至108年度係依我國企業會計準則所編製之個體報表；109年1月1日起則依國際財務報導準則編製個別報表。

TOP ^

### 最近三年度財務比率

項目	年度	108年	109年	110年
財務 比率	毛利率(%)	26.64%	47.27%	51.85%
	流動比率(%)	393.01	635.19	568.13
	應收帳款天數(天)	76	65	75
	存貨週轉天數(天)	163	140	141
	負債比率(%)	27.14	10.73	11.94

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)